

**(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international**



(43) Date de la publication internationale
24 février 2005 (24.02.2005)

PCT

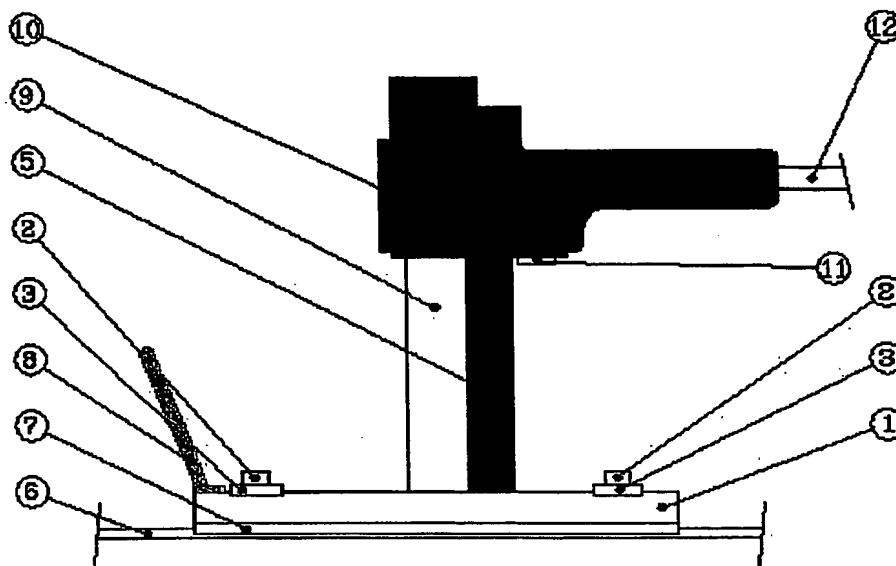
(10) Numéro de publication internationale
WO 2005/016604 A1

- | | |
|--|---|
| <p>(51) Classification Internationale des brevets⁷ : B26D 7/08, B26F 1/38, C03C 17/00</p> <p>(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2004/001842</p> <p>(22) Date de dépôt international : 13 juillet 2004 (13.07.2004)</p> <p>(25) Langue de dépôt : français</p> <p>(26) Langue de publication : français</p> <p>(30) Données relatives à la priorité :
0350342 17 juillet 2003 (17.07.2003) FR</p> <p>(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE [FR/FR]; "Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 Courbevoie (FR).</p> | <p>(72) Inventeur; et</p> <p>(75) Inventeur/Déposant (pour US seulement) : GARREC, Ronan [FR/FR]; 21, place de la Croix Blanche, F-60200 Compiègne (FR).</p> <p>(74) Mandataire : SAINT-GOBAIN RECHERCHE; 39, quai Lucien Lefranc, F-93300 Aubervilliers (FR).</p> <p>(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.</p> |
|--|---|

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: METHOD OF CUTTING A PLASTIC FUNCTIONAL FILM WHICH IS APPLIED TO A SUBSTRATE, SUCH AS A GLASS SHEET

(54) Titre : PROCÉDÉ DE DÉCOUPE D'UN FILM FONCTIONNEL EN MATIÈRE PLASTIQUE APPLIQUÉ SUR UN SUBSTRAT TEL QU'UNE PLAQUE DE VERRE.



(57) Abstract: The invention relates to a method of cutting a plastic functional film, in particular a protective film, which has been applied to a hard substrate (6), such as a glass sheet. The invention is characterised in that the film is cut using an ultrasound cutting device having characteristics and parameters which are selected such that the cut is only made through the thickness of the functional film, leaving the underlying substrate intact.

[Suite sur la page suivante]

WO 2005/016604 A1

- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

Publiée :

- avec rapport de recherche internationale

(57) Abrégé : Ce procédé de découpe d'un film fonctionnel en matière plastique, en particulier d'un film protecteur, à l'état appliqué sur un substrat dur (6), tel qu'une plaque de verre, est caractérisé par le fait qu'on réalise ladite découpe à l'aide d'un dispositif de découpe par ultra-sons, dont les caractéristiques et les paramètres ont été sélectionnés pour que la découpe ne soit effectuée que dans l'épaisseur du film fonctionnel en laissant intact le substrat sous-jacent.